香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# PAX Global Technology Limited 百富環球科技有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號:327)

# 持續關連交易 採購芯片之框架協議

茲提述本公司日期為二零一六年十二月三十日及二零一七年一月十日之公告,內容有關(其中包括)本集團根據現有框架協議向高陽集團採購芯片,該協議將於二零一九年十二月三十一日屆滿。

訂約方於二零一九年十二月三十日訂立二零二零年框架協議,據此,本集團將向高陽集團繼續採購:(i)加密解碼芯片;(ii)處理器芯片;及(iii)非接觸卡讀卡芯片,自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止,為期三年。

於本公告日期,高陽為主要股東,持有本公司已發行股本約33.09%,故根據上市規則第14A章,其為本公司關連人士。因此,二零二零年框架協議項下擬進行之交易構成上市規則項下本公司之持續關連交易。

由於二零二零年框架協議項下代價之年度上限之一項或多項適用百分比率按年計超過0.1%但低於5%,故二零二零年框架協議項下擬進行之持續關連交易僅須遵守上市規則第14A章項下申報、公告及年度審閱之規定,惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准之規定。

#### 背景資料

茲提述本公司日期為二零一六年十二月三十日及二零一七年一月十日之公告,內容有關(其中包括)本集團及高陽集團根據現有框架協議進行之持續關連交易。

由於現有框架協議將於二零一九年十二月三十一日屆滿,且本公司有意於其日常及一般業務過程中向高陽集團繼續採購(i)加密解碼芯片;(ii)採購處理器芯片;及(iii)非接觸卡讀卡芯片(「買賣」),故本公司與高陽訂立二零二零年框架協議,據此,本集團將採購且高陽集團將出售芯片,自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止,為期三年。

# 二零二零年框架協議

二零二零年框架協議之主要條款概述如下:

日期: 二零一九年十二月三十日

訂約方: (1) 本公司(作為買方);及

(2) 高陽(作為賣方)(統稱「訂約方」)

主體事項: 根據個別協議之條款,本集團將採購而高陽集團將出售芯

片。

個別協議: 於年期內,本集團各成員公司與高陽集團將不時訂立個別協議(「個別協議」),當中將載列個別買賣之條款並按下列原

則磋商:

(a) 買賣將經公平磋商後按正常或較佳商業條款進行;

(b) 芯片之價格將參考高陽集團所出售予其客戶之相同或 同類型產品之價格及業內同類型產品之當時市價釐定;

及

(c) 買賣之條款及條件(包括整體考慮價格、訂貨量、償付、 裝運及出貨條款)將不遜於本集團不時獲獨立第三方提 供之條款及條件。

年期:

二零二零年框架協議自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止,為期三年(「**年期**」)。

## 年度上限

#### 過往數據

下表載列截至二零一七年十二月三十一日、二零一八年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零一九年十一月三十日止十一個月本集團自高陽集團採購的芯片的概約總值以及截至二零一九年十二月三十一日止三個年度各年的年度上限:

	截至 二零一七年 十二月	截至 二零一八年 十二月	截至 二零一九年 十二月
	三十一日	三十一日	三十一日
	止年度	止年度	止年度
	(經審核)	(經審核)	
	千港元	千港元	千港元
年度上限	65,000	70,000	75,000
實際代價	59,966	67,587	45,105
			(截至
			二零一九年
			十一月三十日
			止十一個月
			(未經審核)

就董事所知,截至本公告日期,概無超過現有框架協議項下的年度上限。

#### 建議年度上限

根據二零二零年框架協議,截至二零二零年十二月三十一日、二零二一年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止各年度之買賣代價之年度上限如下:

期間 代價不得超過

二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日 八千萬港元 二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日 九千萬港元 二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日 一億一千萬港元

於釐定上述年度上限時,董事會已考慮下列因素:

- (i) 現有框架協議項下之過往買賣代價及本集團電子支付終端相關產品之過往銷售額;
- (ii) 於年期內電子支付終端相關產品之估計市場需求以及本集團之預期業務發展及 能力;及
- (iii) 芯片之估計市價。

#### 保障股東利益之措施

二零二零年框架協議項下擬進行之持續關連交易乃按非獨家基準進行,即表示本集團將維持向其他供應商採購芯片之酌情權。根據二零二零年框架協議,任何協議方可藉向另一方發出三(3)個月事先書面通知終止協議。

為確保股東權益得到充分保障,本公司已採納一項供應商管理政策,當中載有針對潛在及現有供應商及其產品和表現之供應商篩選程序、質量測試方法及整體考核評估系統,以確保自現有供應商採購之產品之質量及條款與類似產品之市場標準相比,對本集團而言同等優良或更為有利,其詳情載列如下:一

- 物控部門、研發中心及質量管理部門負責以邀請提交報價之方式,持續在公開市場上物色及評估潛在供應商。本公司已執行一項標準程序流程,據此負責部門須對潛在供應商進行盡職審查(包括現場參觀)並向彼等取得產品樣品及報價。根據不同類別(如定價、產品質量、質量控制、交貨及售後服務)之個別評分,對各潛在供應商給予整體評分,其中獲良好或優秀評分之供應商方可獲聘;
- 質量管理部門及採購部門負責對現有供應商及其產品(包括高陽集團及其供應之產品)進行半年度及年度考核評估。會對定價、產品質量、準時交貨及售後服務進行檢查,亦會進行現場評估確保產品乃按妥善程序製造。在考慮各供應商於不同方面之表現後,將給予其一項整體評分。其中得到優秀評分之該等供應商將納入本公司之優先供應商名單中,而獲得低評分之供應商則可能會從供應商名單中移除;

遵循供應商管理政策下之採購及評估程序並計及多項因素(包括多名提供與高陽集團類似產品之獨立第三方供應商之產品定價及質量、高陽集團及其他獨立第三方供應商之公司背景、聲譽和客戶及售後服務之可靠性及質量)後,本公司已釐定,高陽集團就採購相關芯片向本集團提供之條款更優於其他獨立第三方供應商。此外,因本集團與高陽集團之緊密及長期關係,高陽集團已為本集團提供支援性客戶及售後服務和按時及可靠的產品交付。

因此,董事認為向高陽集團採購芯片將有助於維持本集團之生產效益並為本集團之整體營運帶來好處。展望未來,本集團將繼續對高陽集團及其他供應商之合約履約情況進行定期審閱及評估。具體而言,本公司已就其持續關連交易採納(其中包括)以下內部控制措施:

- 本公司的外部核數師將進行年度審閱,並獨立確認彼等並無注意到任何事情可 使他們認為二零二零年框架協議項下擬進行的持續關連交易(其中包括)未根據 本集團定價政策進行,且買賣代價超過年度上限;
- 本公司審核委員會將定期審閱內部控制制度,以確保對個別買賣有效實施內部 控制程序;
- 獨立非執行董事將按買賣情況根據季度報告審閱持續關連交易、年度上限使用、市場最新資料,包括本集團於各市場的表現、定價趨勢及其他相關資料,並確定相關內部控制措施的實施情況,以確保不超過年度上限及確保持續關連交易均按照個別協議條款進行;及
- 董事(包括獨立非執行董事)將定期監察及審閱擬進行的持續關連交易,以確保 (其中包括)有關條款屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

### 訂立二零二零年框架協議之理由及裨益

本集團是一家電子支付終端解決方案供應商,主要從事開發及銷售電子支付終端產品以及提供相關服務。由於芯片為電子支付終端相關產品之必要零部件,故預期本集團將於其日常及一般業務過程中對芯片有持續需求。

鑑於高陽集團及本集團過往的交易,彼等擁有良好的往績,董事認為訂立二零二零年框架協議可確保本集團生產電子支付終端相關產品所用芯片獲得持續及穩定之供應。此外,其降低本集團的生產成本,原因是與其他市場供應商相比,高陽集團(少數幾家芯片供應商之一,滿足本集團的生產需要且有關規格並不常見)可提供具競爭力且相對較低的價格。

基於上述原因,董事(包括獨立非執行董事)認為,二零二零年框架協議之條款屬公平合理,並經訂約方公平磋商後按正常或較佳商業條款於本集團之日常及一般業務過程中訂立,且符合本集團及其股東之整體利益。

#### 有關本公司及高陽的資料

本公司為投資控股公司, 連同其附屬公司主要從事開發及銷售電子支付銷售點終端(電子支付終端)產品、提供維護及安裝服務。於本公告日期, 本公司由高陽間接持有約33.09%, 其為本公司主要股東, 故根據上市規則第十四A章, 彼等為本公司的關連人士。

高陽為一間於百慕達註冊成立之有限公司(其股份於聯交所上市),連同其附屬公司主要從事提供支付交易處理解決方案,並透過五個分部經營,即支付交易處理解決方案分部、金融解決方案分部、信息安全芯片及解決方案分部、平台運營解決方案及電能計量產品及解決方案分部。於本公告日期,高陽為本公司的主要股東,持有本公司已發行股本約33.09%。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,高陽的主要股東的最終實益擁有人為渠萬春先生(間接持有高陽約23.25%的股本)及車峰先生(間接持有高陽約12.04%的股本),且彼等均為本公司獨立第三方。

#### 上市規則之涵義

於本公告日期,高陽為主要股東,持有本公司已發行股本約33.09%,故根據上市規則第14A章,其為本公司關連人士。因此,二零二零年框架協議項下擬進行之交易構成上市規則項下本公司之持續關連交易。

由於二零二零年框架協議項下代價之年度上限之一項或多項適用百分比率按年計超過0.1%但低於5%,故此持續關連交易僅須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告及年度審閱之規定,惟獲豁免遵通函及守獨立股東批准之規定。

現時擔任本公司董事之李文晉先生亦同時為高陽之董事,被視為於二零二零年框架協議項下擬進行之交易中擁有重大權益,因此,彼已按照上市規則第13.44條就批准二零二零年框架協議,包括年度上限之董事會決議上放棄表決權利。

#### 釋義

於本公告內,下列詞彙具有以下涵義:

「二零二零年 指本公司與高陽所訂立日期為二零一九年十二月三十日 框架協議」 之框架協議,內容有關本集團向高陽集團採購芯片;

「董事會」 指 董事會;

「芯片」 指 非接觸卡讀卡芯片、處理器芯片及加密解碼芯片之統

稱;

「本公司」 指 百富環球科技有限公司,於百慕達註冊成立之有限公

司,其股份於聯交所上市(股份代號:327);

「代價」 指 買賣之總合約價值;

「非接觸卡讀卡芯片」 指 非接觸卡讀卡芯片;

「處理器芯片」 指 加密安全處理器芯片;

「董事」 指 本公司董事;

「電子支付終端」 指 電子支付銷售點終端;

「現有框架協議」 指 本公司與高陽所訂立日期為二零一六年十二月三十日

之框架協議,內容有關本集團向高陽集團採購芯片;

「本集團」 指 本公司及其附屬公司;

「高陽」 指 高陽科技(中國)有限公司,於百慕達註冊成立之有限

公司,其股份於聯交所上市(股份代號:818);

「高陽集團」 指 高陽及其附屬公司;

「港元」 指 香港法定貨幣港元;

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區;

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則;

「加密解碼芯片」 指 磁條卡加密解碼芯片;

「股東」 指 本公司股東;

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司;及

指 百分比。

承董事會命 百富環球科技有限公司 公司秘書 張仕揚

香港,二零一九年十二月三十日

於本公告日期,董事會成員包括三名執行董事聶國明先生、蘆杰先生及李文晉先生; 以及三名獨立非執行董事葉偉明先生、吳敏博士及文國權先生。